

2024年領航基金 PGIM保德信科技島基金

聚焦高純度AI供應鏈

2024年10月

保德信投信獨立經營管理。

保德信及其岩石商標為專有服務標誌，未經本公司事先同意前，不得使用。



大綱

市場展望

基金投資流程

基金特色優勢

市場展望

四大投資亮點 台灣科技股機會



美國科技股續強 台廠供應鏈續旺

- AI熱潮為美國科技帶為強動能，2023年以來台灣電子產業推升台灣加權指數屢創新高，在全球終端需求逐步發酵的態勢下，產業機會將加速放大。



AI燒不退 台廠外銷訂單續旺

- AI熱潮持續奠定台廠在全球供應鏈中的核心地位，訂單滿載將加速推升企業獲利，持續強化企業的價格強勢主導性。



晶圓代工技術無可取代 全球營收拿7成

- 初估2026年半導體產業獲利將突破8千億美元大關，年營收佔比可望拿下全球7成市佔的台廠晶圓代工，將為整體產業供應鏈引爆訂單量。



AI滲透終端電子 SEMI強勢撐台廠

- AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求，隨龍頭大廠引領的AI晶片加速進入市場，相關終端電子需求將推升台廠持續上攻。

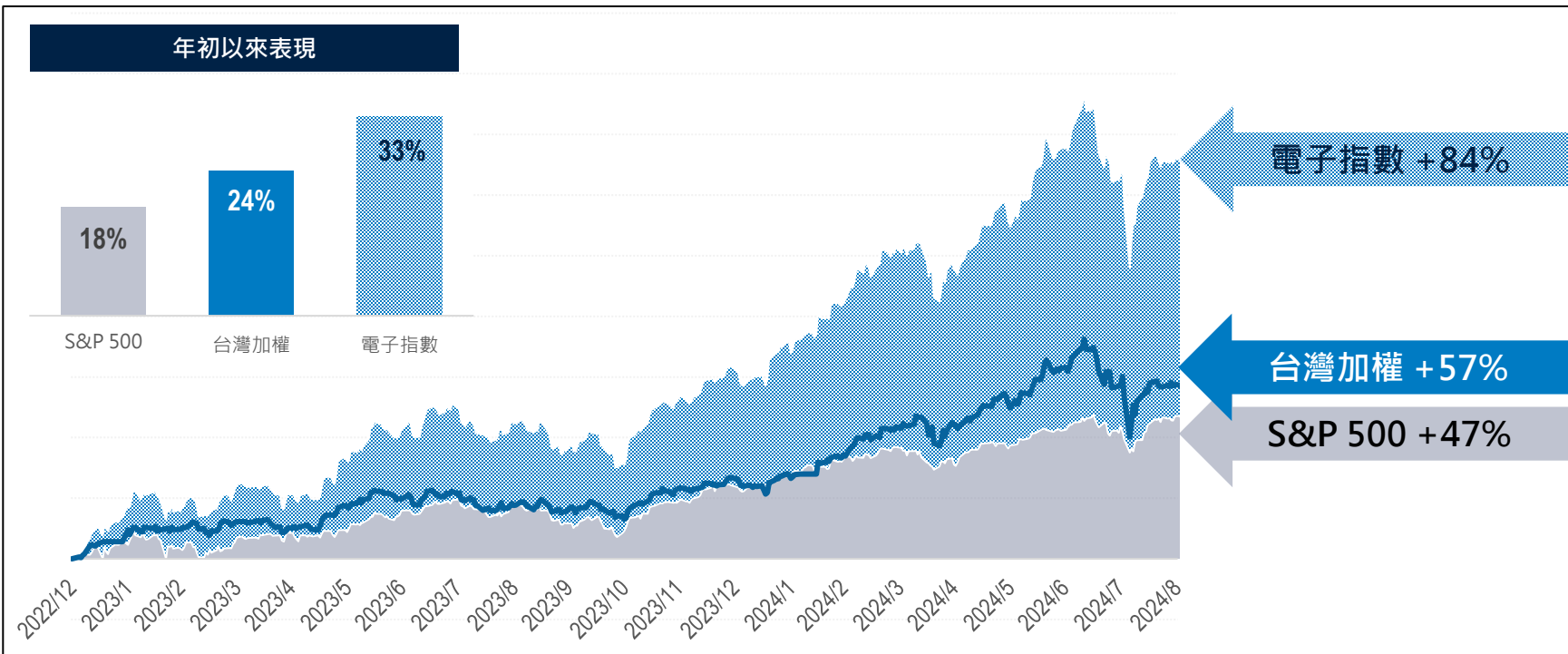
資料來源：保德信投信整理，2024/09。

注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。

科技掌握全趨勢 推升台股齊力飆

✓ AI趨勢浪潮下，2023年以來台灣電子產業推升台灣加權指數屢創新高，衍生需求推動科技發展再創歷史輝煌新頁，預期在全球終端需求逐步發酵的態勢下，產業機會將加速放大。

2023年以來電子指數帶頭領漲

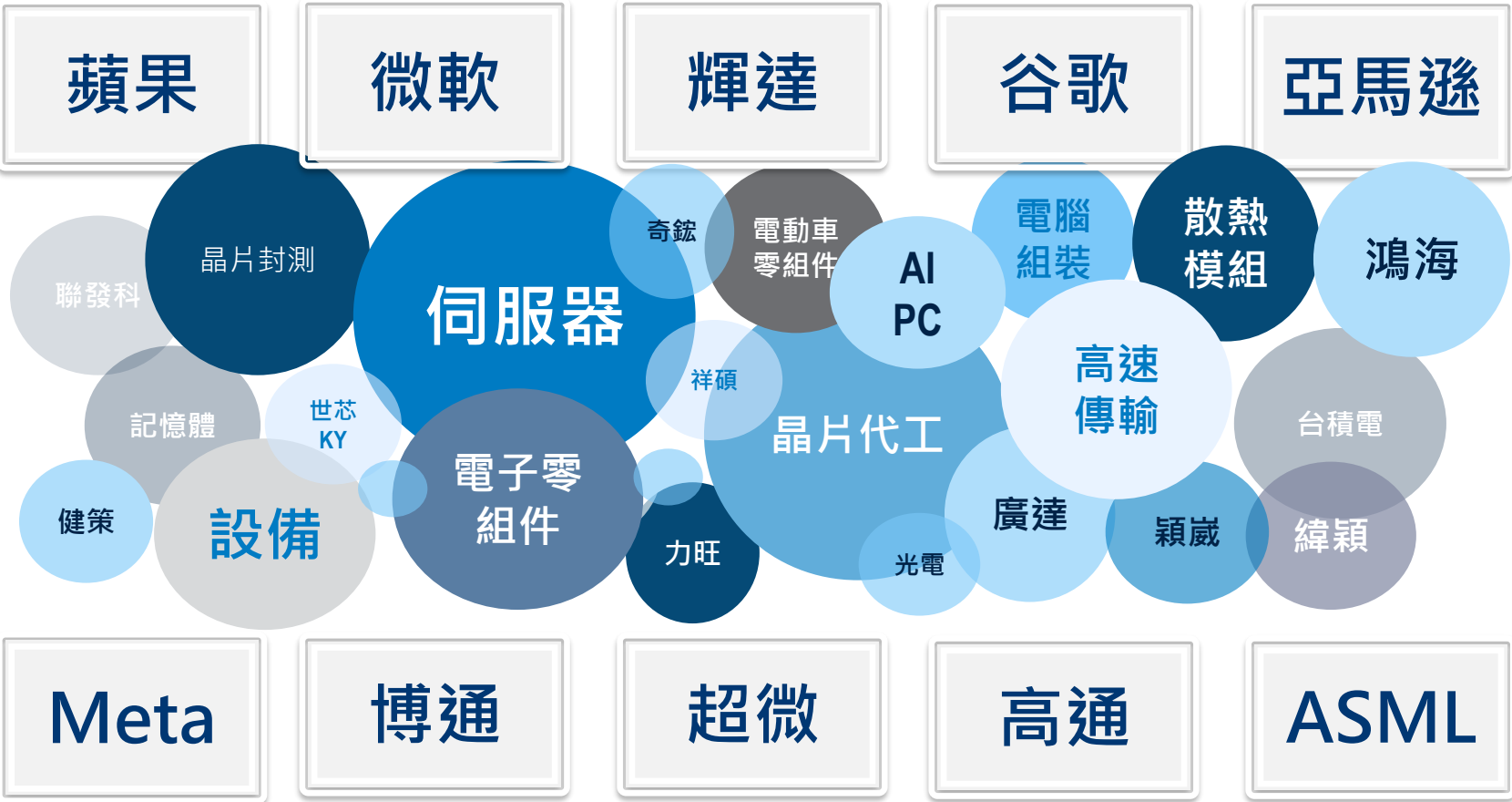


資料來源：Bloomberg，保德信投信整理，2022/12/31~2024/8/31。
注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

AI科技趨勢不可逆 上游供應鏈產能持續強

✓ AI熱潮為全球科技帶來強動能，台廠相關供應鏈將直接受惠，訂單滿載將持續放大企業獲利。

全球科技龍頭帶動台廠供應鏈訂單大放量



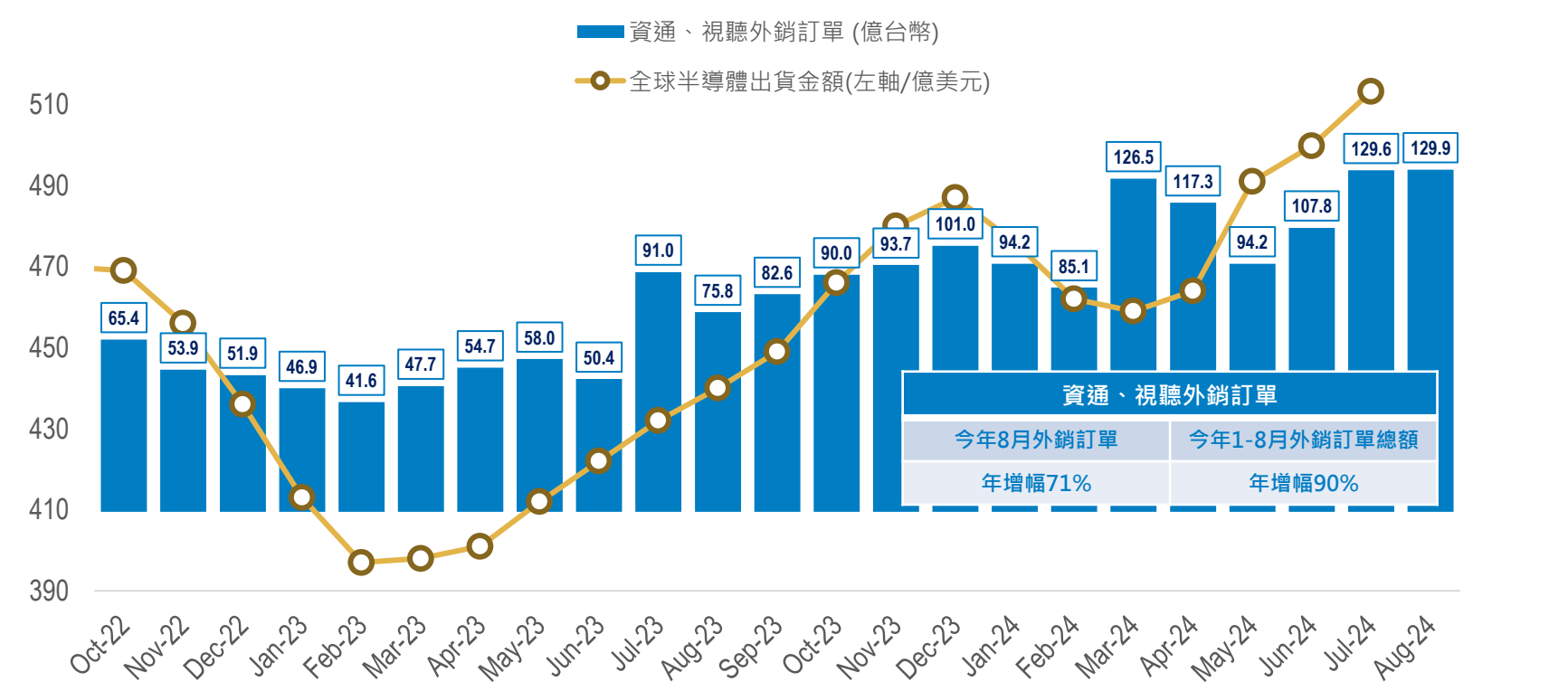
資料來源：保德信投信整理，2024/8/31。

注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

全球半導體需求續強 推動台廠外銷訂單續旺

✓ AI熱潮持續為美國科技帶來強動能，台廠在全球供應鏈中的地位愈發重要。訂單滿載將加速推升企業獲利，台廠亦將憑藉節節攀升的科技產業地位，持續強化企業的價格強勢主導性。

全球半導體需求帶動台廠供應鏈訂單大放量



資料來源: macromicro, 保德信投信整理 · 2024/9/20。

電子產業迎旺季 股價揚升展潛力

✓ 在年底旺季帶動之下，過去電子產業表現在第4季皆相對突出，我們認為在全球科技前景持續朝正向發展的趨勢下，不僅將持續推升企業獲利，亦將放大未來股價上漲潛力。

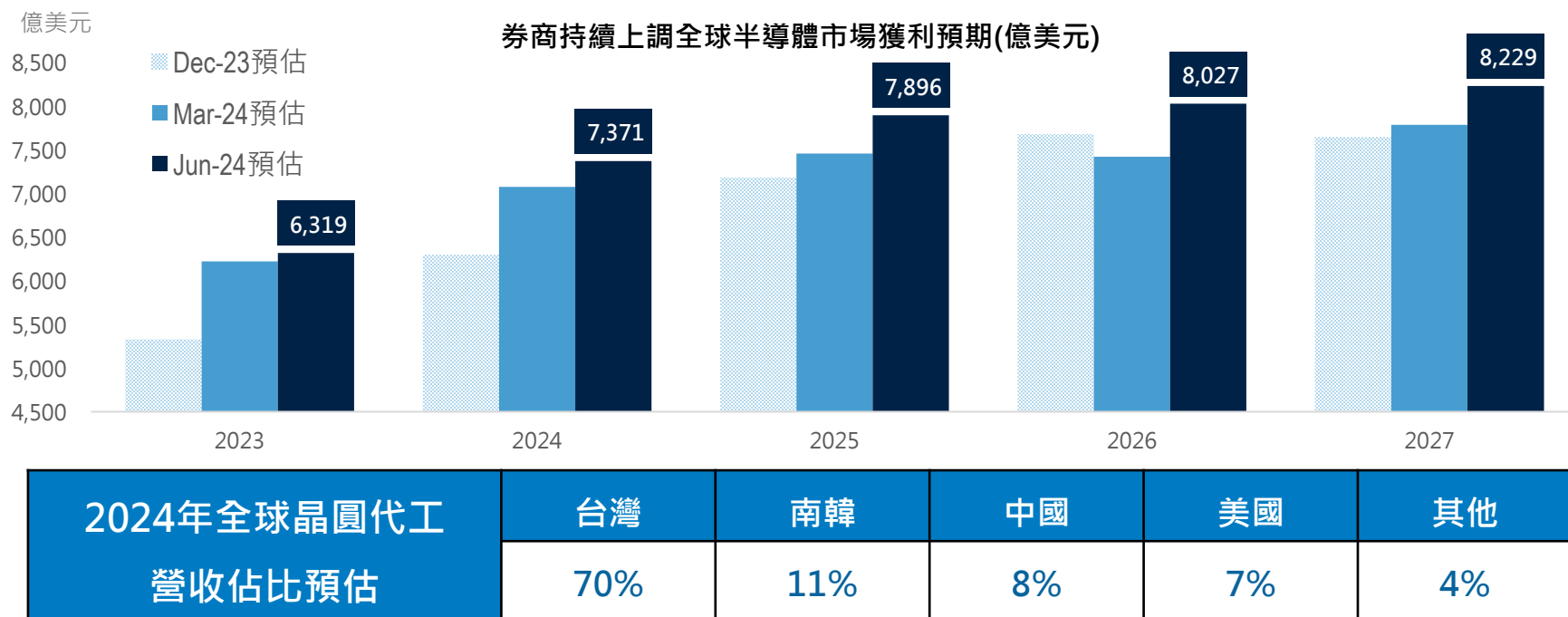
電子指數季漲跌幅				
	第1季	第2季	第3季	第4季
2019	10.9%	-0.9%	6.9%	15.8%
2020	-18.6%	21.1%	15.2%	20.1%
2021	13.9%	0.9%	-4.3%	10.6%
2022	-5.6%	-18.7%	-9.5%	5.7%
2023	17.5%	8.0%	-2.2%	12.2%
平均	3.6%	2.1%	1.2%	12.9%
2024	19.1%	16.5%	?	?

資料來源：Bloomberg，PGIM保德信投信整理，2024/8/31。

注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。

半導體產業前景佳 台廠營收佔比拿7成

- ✓ 券商持續上調全球半導體產業的獲利，並預期2026年獲利模規將突破8千億美元大關，並較2023年成長27%。年營收佔比可望拿下全球7成市佔的台廠晶圓代工，將在全球需求持續帶動之下，為整體產業供應鏈引爆訂單量。



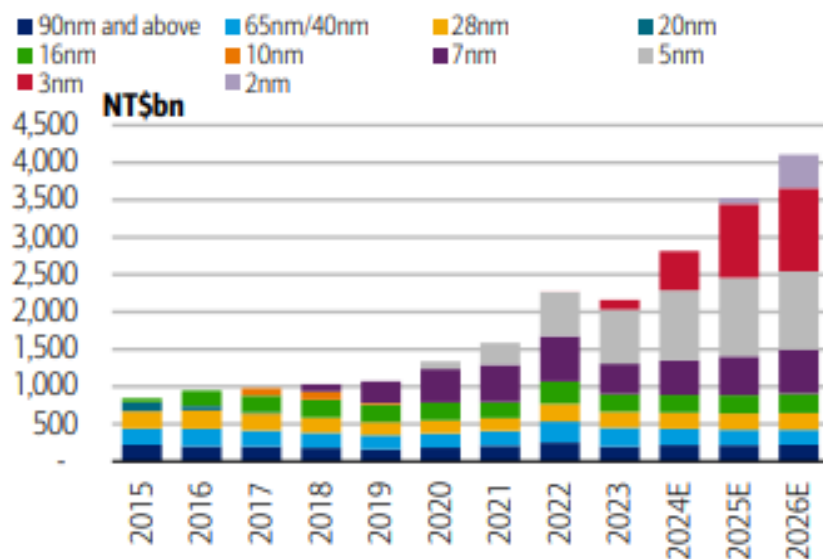
資料來源：上圖 Gartner · KGI · 2024/7/18；下表Trendforce · 2024/2/23 · 保德信投信整理保德信投信整理。

先進製程晶片獨領風騷

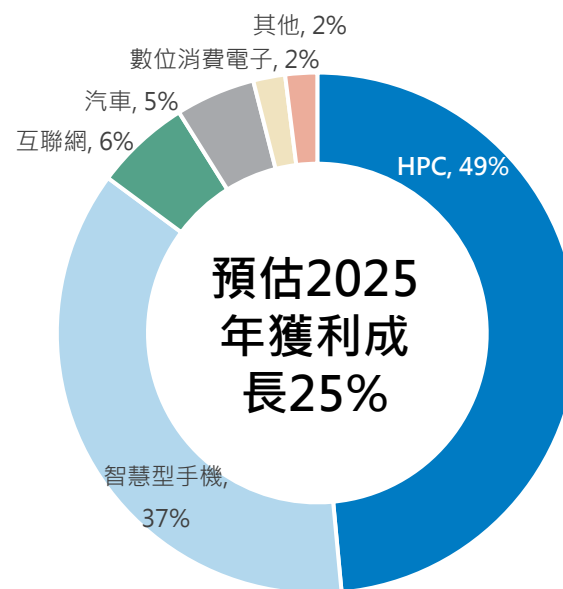
HPC、智慧型手機需求旺

- ✓ 市場預期全球晶圓代工龍頭台積電明年在7奈米以下先進製程的營收佔比將提升至7成以上，目前3奈米以下先進製程晶片已拿下全球9成以上市占，預期其技術優勢將帶動整體台廠產業鏈競爭力。
- ✓ 就終端平台而言，預期高速傳輸與智慧型市場所帶動的市場需求，將為明年整體獲利來源的主動能，初估其整體獲利佔比將達8成以上。

TSMC各製程獲利佔比



TSMC 2025年各平台獲利佔比預估

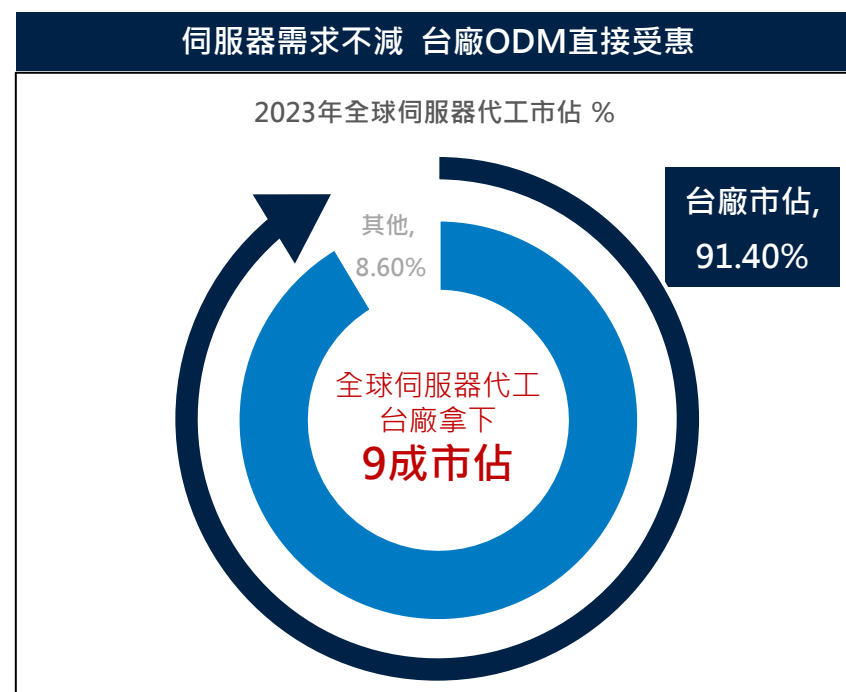
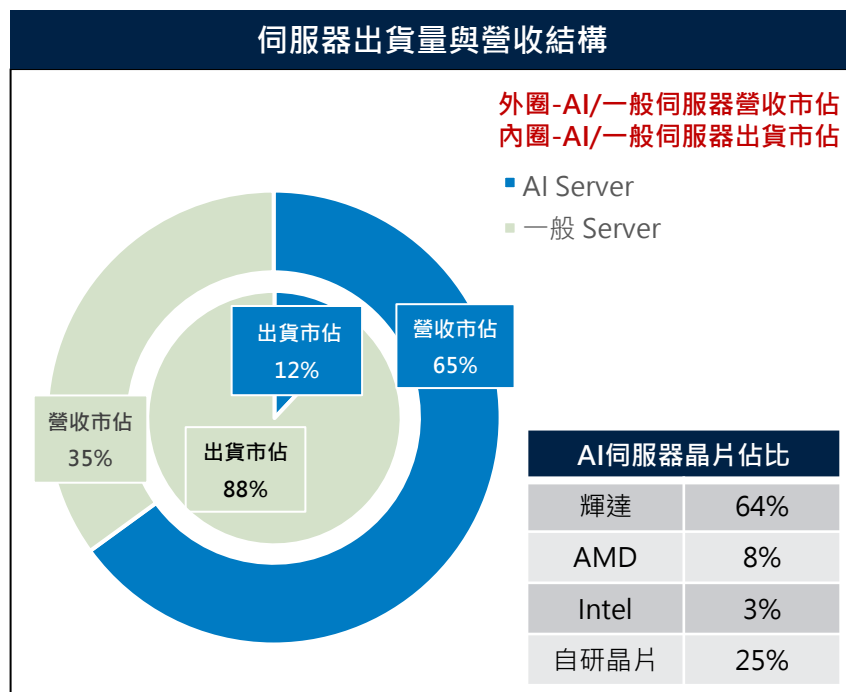


資料來源：BofA Research，2024/7/18，保德信投信整理，2024/9/13。

注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

AI伺服器強需求 台廠ODM營收顯神威

- ✓ 儘管市場預期今年一般伺服器出貨佔比仍為大宗並上看9成，但就企業獲利角度而言，AI Server的營收成長貢獻大幅高於一般型伺服器，預估2024年AI Server的整體產值將佔整體伺服器市場的65%，其中又以AI晶片龍頭輝達將拿下整體市佔64%。
- ✓ 伺服器需求將持續推升相關供應鏈企業營收，而拿下全球9成市佔的台廠代工廠獲利力將再顯神威！

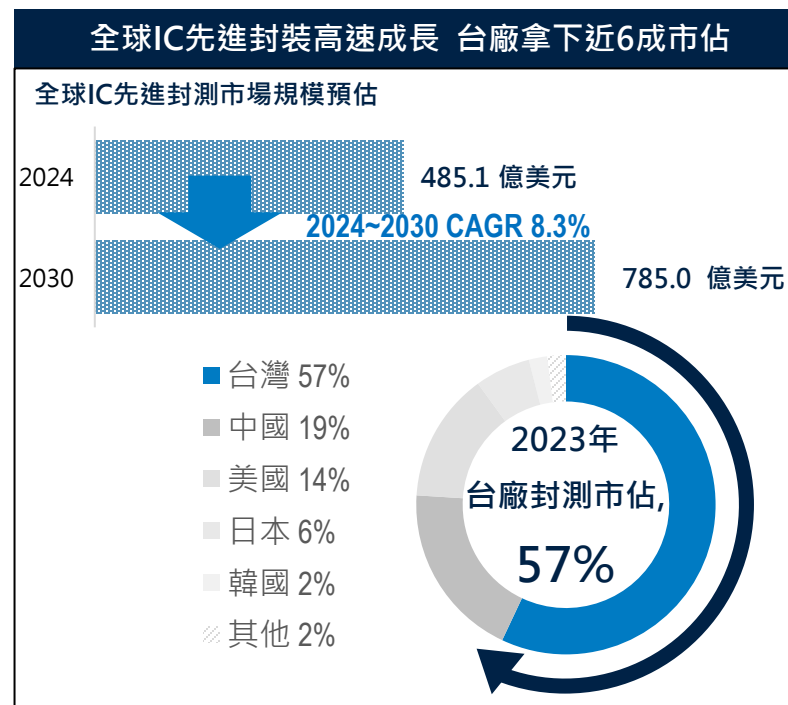
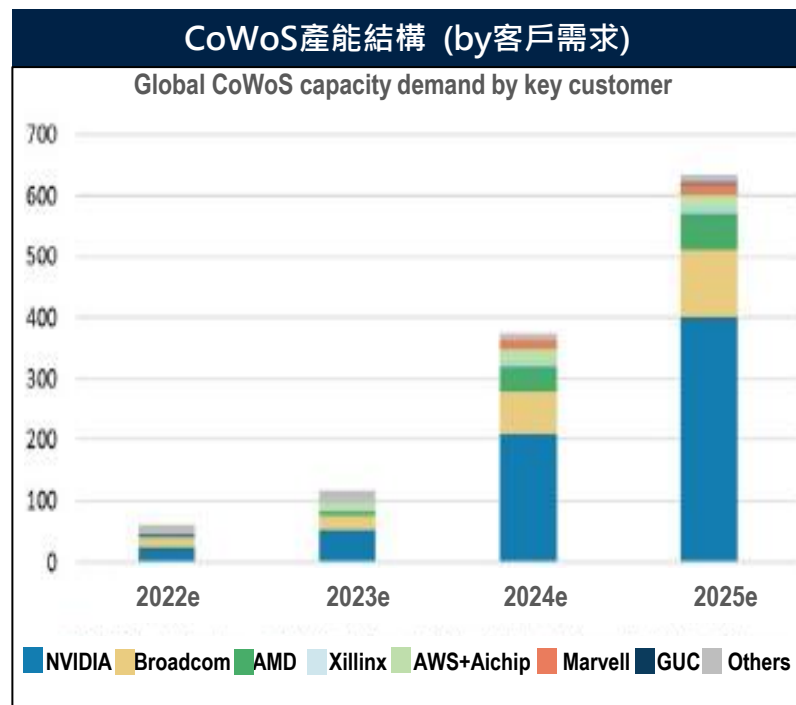


資料來源：左圖-TrendForce，2024/7/17;右圖-MIC, 2024/1, 保德信投信整理，2024/9/20。

注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

AI晶片攻市佔 封裝產能大爆量

- ✓ AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求，透過晶片堆疊並封裝在基板上，並根據2.5D與3D排列的形式減少晶片的空間並強化AI效能，隨龍頭大廠引領的AI晶片加速進入市場，CoWoS產能將持續放大。
- ✓ 隨著NVIDIA的Blackwell平台將於2025年正式放量，並成為全球 AI 伺服器出貨主力，初估GB200AI晶片產能在明年將上看220萬顆，屆時將同時帶動CoWoS需求成長。



資料來源：左圖-Morgan Stanley, 2024/6/19; 右上Research and Market, 2024/3, 保德信投信整理; 右下-Bloomberg, 2024/6/21。

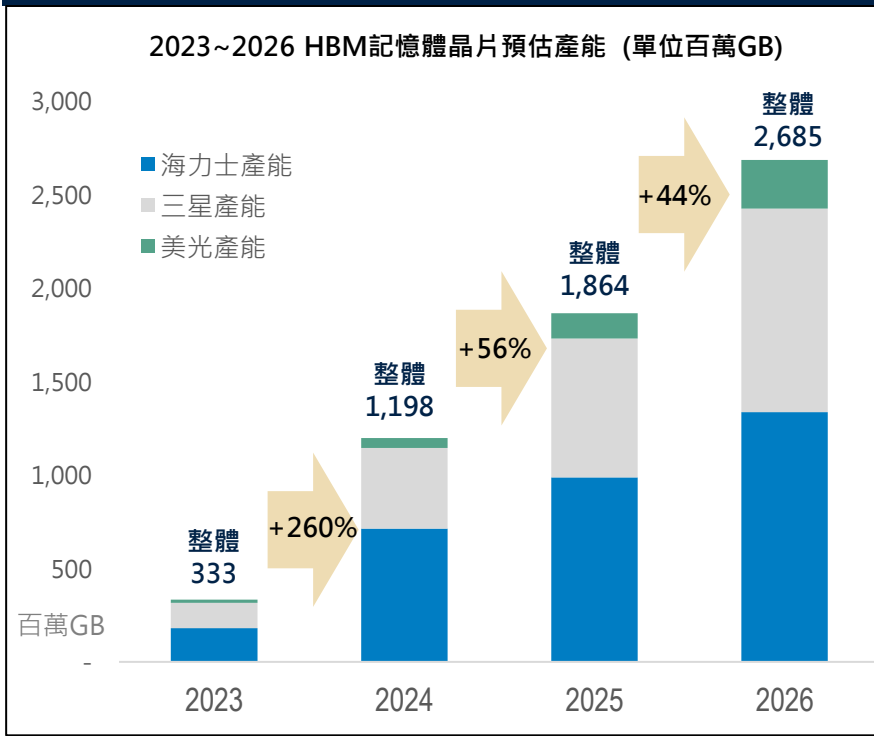
注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

HBM-記憶體族群聖盃

AI、自駕技術推升需求急升

- ✓ AI伺服器所需要的記憶體量，是傳統伺服器的5~6倍，HBM的記憶體堆疊技術為目前AI伺服器的高需求記憶體量的主要解決方案，市場預期未來自駕車市場也將為HBM重要的應用場景，且在AI伺服器與自駕技術的高速發展推動下，HBM的強需求週期將上看10年。

HBM記憶體晶片產能急速拉升 供需仍呈現短缺



We see an undersupplied HBM market over the next few years

	2023	2024E	2025E	2026E
SK Hynix ('000 GB)	179,952	712,970	986,700	1,336,455
yoy change	67%	296%	38%	35%
Blended # of dies per 12" wafer	445	445	440	440
HBM wafer starts (kwpm/month)	34	90	115	135
yoy growth (%)	43%	169%	28%	17%
Blended monodie density (GB)	15	18	20	23
Total DRAM supply ('000 GB)	8,001,250	9,614,332	11,690,731	13,794,804
HBM portion (%)	2.2%	7.4%	8.4%	9.7%
Samsung ('000 GB)	135,145	432,124	742,500	1,088,208
yoy change	45%	220%	72%	47%
Blended # of dies per 12" wafer	445	445	440	440
HBM wafer starts (kwpm/month)	37	95	125	150
yoy growth (%)	45%	157%	32%	20%
Blended monodie density (GB)	14	18	20	23
Total DRAM supply ('000 GB)	11,678,125	13,855,578	16,022,750	19,071,987
HBM portion (%)	1.2%	3.1%	4.6%	5.7%
Micron ('000 GB)	17,500	53,000	135,000	260,000
yoy change	17%	203%	155%	93%
Implied Micron share (%)	5%	4%	7%	10%
Total DRAM supply ('000 GB)	5,693,335	7,153,356	8,223,873	10,148,874
HBM portion (%)	0.3%	0.7%	1.6%	2.6%
Total HBM supply ('000 GB)	332,597	1,198,095	1,864,200	2,684,663
yoy change	54%	260%	56%	44%
Total HBM demand ('000 GB)	343,292	1,230,837	1,899,466	2,709,683
yoy change	59%	259%	54%	43%
HBM supply/demand	-3.1%	-2.7%	-1.9%	-0.9%

Note: Data for 2023 are estimates.
Source: Goldman Sachs GIR.

資料來源: Goldman Sachs GIR · 2024/6/23 · 保德信投信整理。

注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

AI智慧型手機強攻市佔

台廠晶片龍頭狂接單

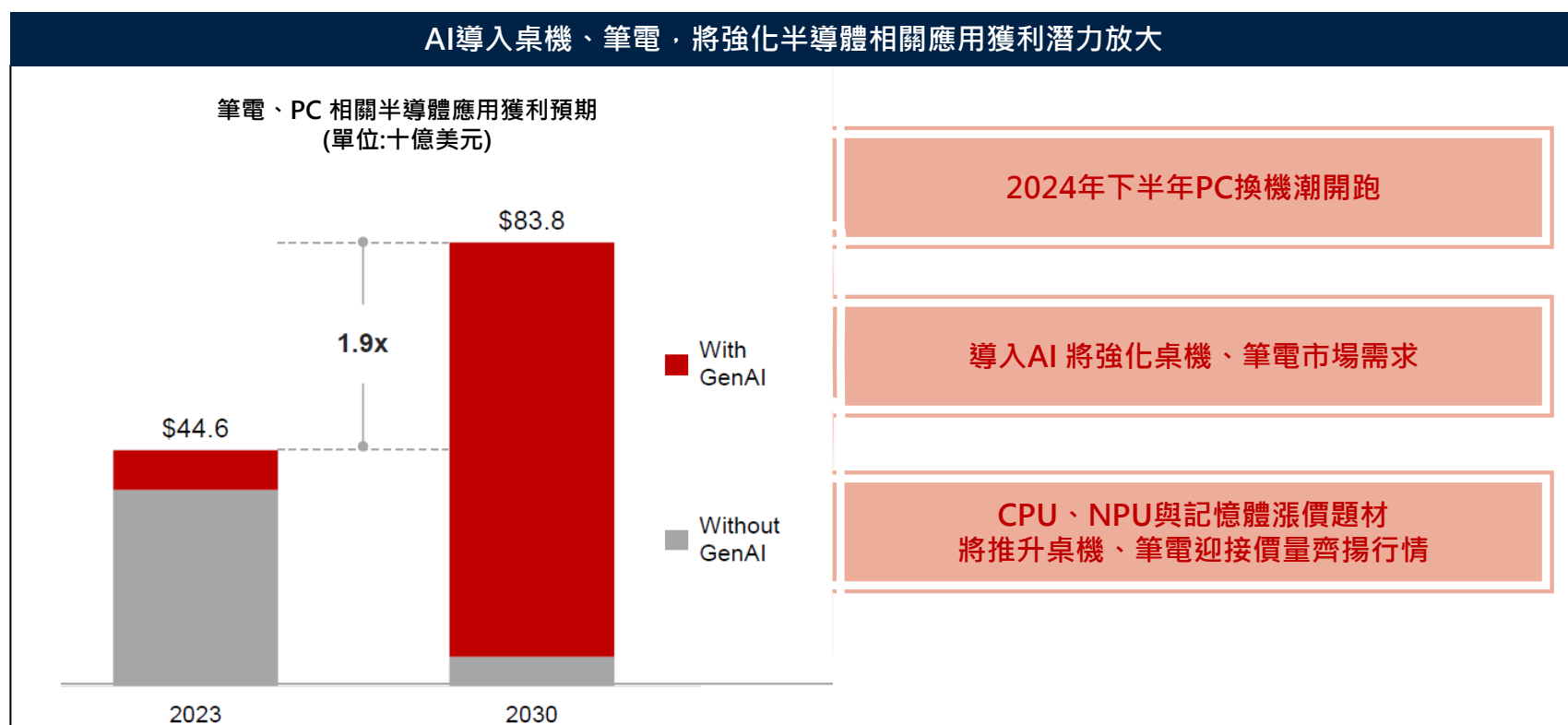
- ✓ AI智慧型手機的市場熱度再掀浪潮，研調機構IDC報告預期，全球AI智慧型手機在2028年前將可望以近80%的複合年成長率擴張，並在近期上調全年整體智慧型手機出貨量至12.3億支，即年增幅6%。
- ✓ 台廠先進製程晶片技術獨占鰲頭，拿下全球AI智慧型手機晶片9成以上市佔。



資料來源：左表-各公司資訊 ;右圖-IDC，2024/7/5，保德信投信整理。
注意：本資料所示之指數及個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

終端消費撐動能 AI助攻桌機、筆電換機潮

- ✓ 隨2024年下半年的桌機、筆電換機潮展開，預期在AI PC進攻市售的動能下，需求有望放大。
- ✓ 其中CPU、NPU價格在2030年前上看2成漲價空間，記憶體晶片在HBM與SSD的成本帶動下，亦將上看3成的漲價潛力，在價量齊揚的帶動下，在桌機、筆電的半導體相關應用可望迎接近2倍的獲利成長。



資料來源：Counterpoint，2024/7，保德信投信整理。

科技掌握全趨勢

SEMI強勢撐台股

過去10年單年漲跌幅										
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024YTD
半導體	台灣加權	半導體	半導體	半導體	半導體	半導體	半導體	台灣加權	電子類股	半導體
29.6%	-10.4%	16.8%	27.3%	-7.4%	48.4%	58.2%	24.2%	-22.4%	39.5%	42.6%
電子類股	半導體	電子類股	電子類股	台灣加權	電子類股	電子類股	台灣加權	電子類股	半導體	電子類股
20.0%	-10.4%	12.8%	19.4%	-8.6%	36.0%	36.5%	23.7%	-26.6%	38.8%	32.9%
台灣加權	電子類股	台灣加權	台灣加權	電子類股	台灣加權	台灣加權	電子類股	半導體	台灣加權	台灣加權
8.1%	-11.5%	11.0%	15.0%	-12.1%	23.3%	22.8%	21.6%	-31.8%	26.8%	24.2%
各指數期間漲跌幅-截至8/31										
		1個月 (%)	3個月 (%)	6個月 (%)	年初至今 (%)	1年 (%)	2年 (%)	3年 (%)	5年 (%)	
台灣半導體指數		1.3	10.6	25.8	42.6	60.6	77.4	39.6	231.1	
台灣電子指數		1.1	7.3	22.1	32.9	45.1	69.8	43.5	168.4	
台灣加權指數		0.3	5.2	18.1	24.2	33.9	47.5	27.3	109.7	
S&P500指數		2.3	7.0	11.2	18.4	25.3	42.8	24.9	93.0	
MSCI世界指數		2.4	6.1	9.6	14.7	21.5	36.0	12.5	63.2	

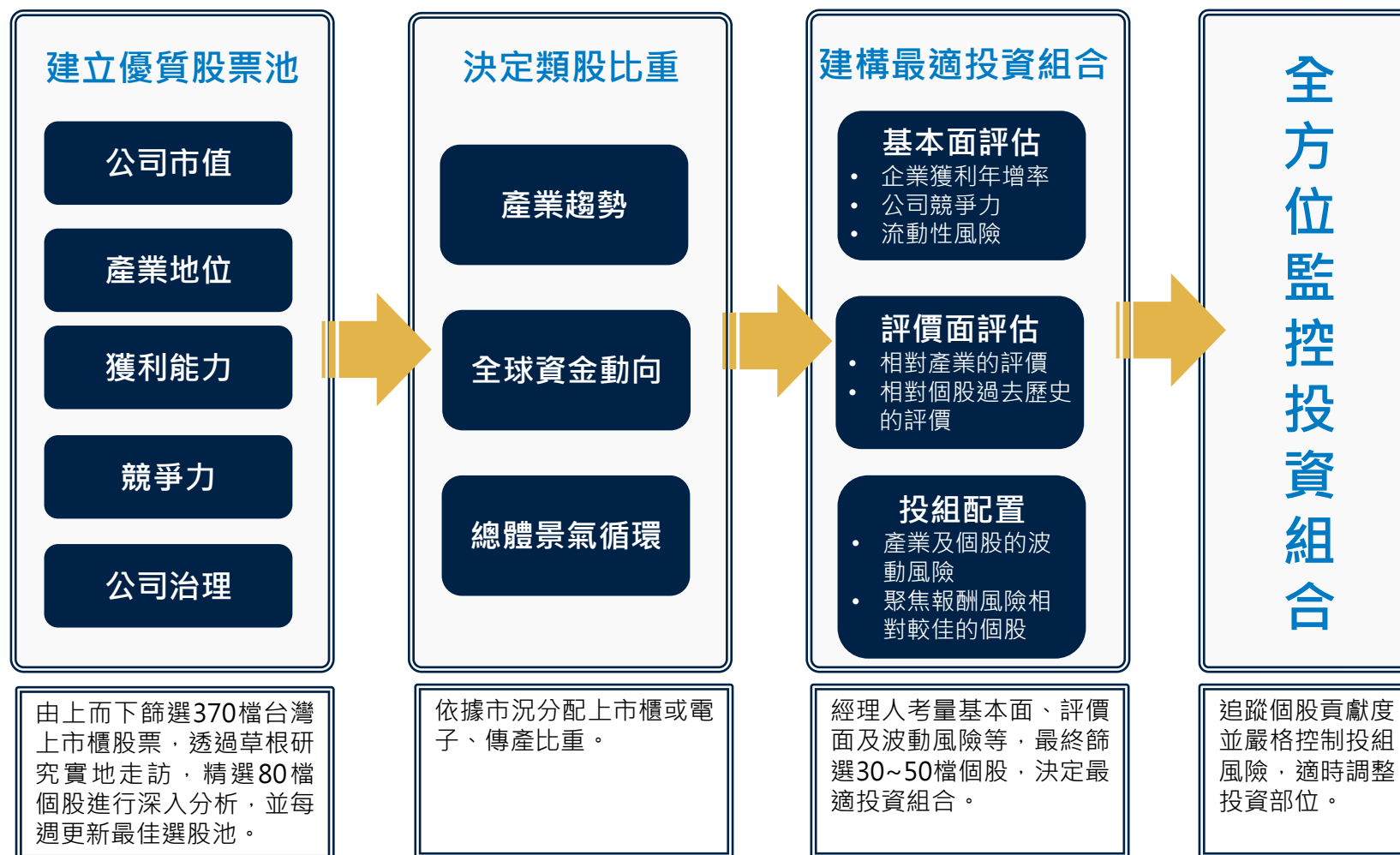
資料來源：Bloomberg，保德信投信整理，截至2024/8/31。

注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。

基金投資流程

基金投資流程

掌握科技趨勢 建構全方位投資組合



基金特色優勢

基金特色 | PGIM保德信科技島基金

掌握AI人工智慧商機

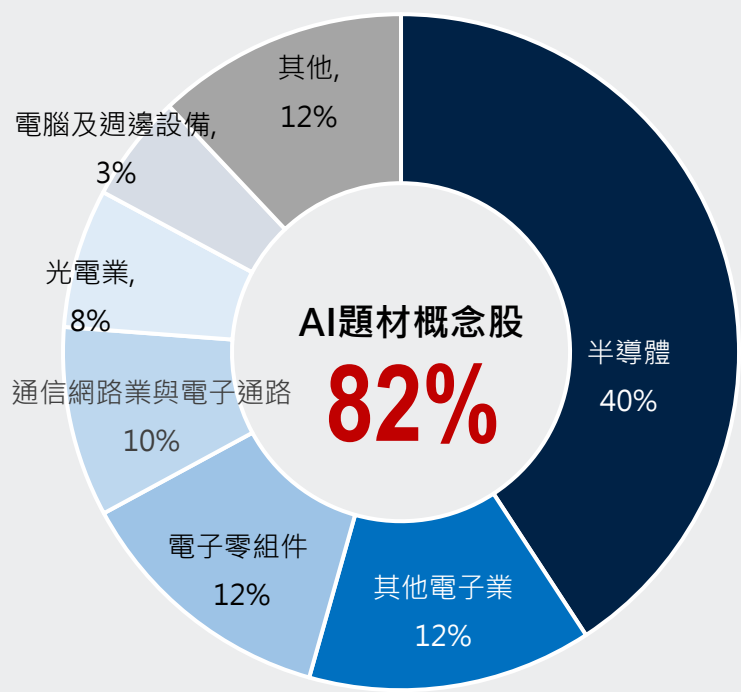
特色

Taiwan **強基底**
純正科技股

Essential **關鍵科技**
AI佔比高達8成

Chips **完整供應鏈**
半導體為主 精選持股30-50檔

PGIM保德信科技島持股比例

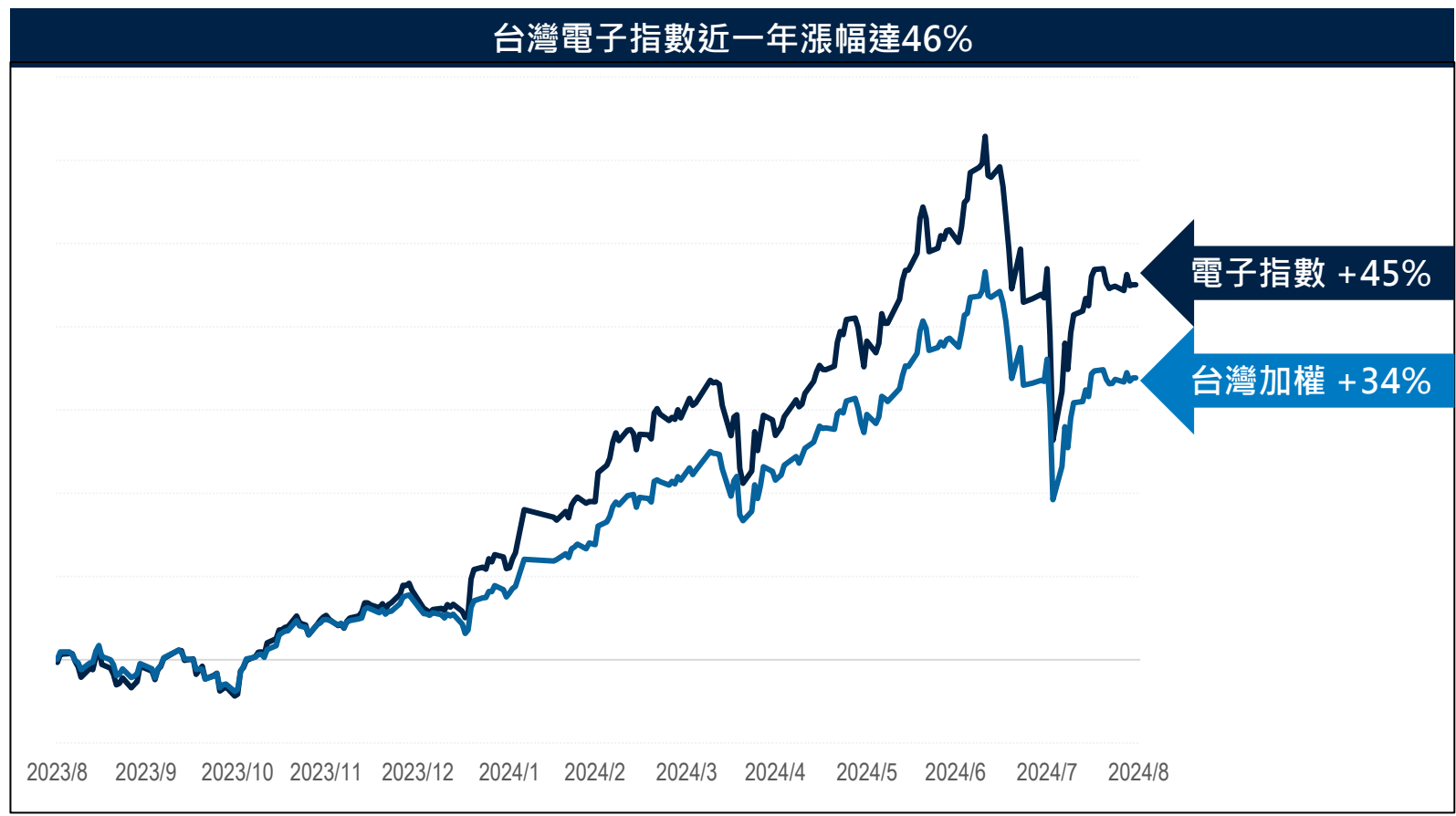


- AI 智慧型手機
- 資料中心
- 高效能運算
- 自動駕駛
- 電子零組件

資料來源：基智網，保德信持股比例截至2024/9/13，保德信投信整理。

注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

基金特色 | Taiwan 強基底 純正科技股



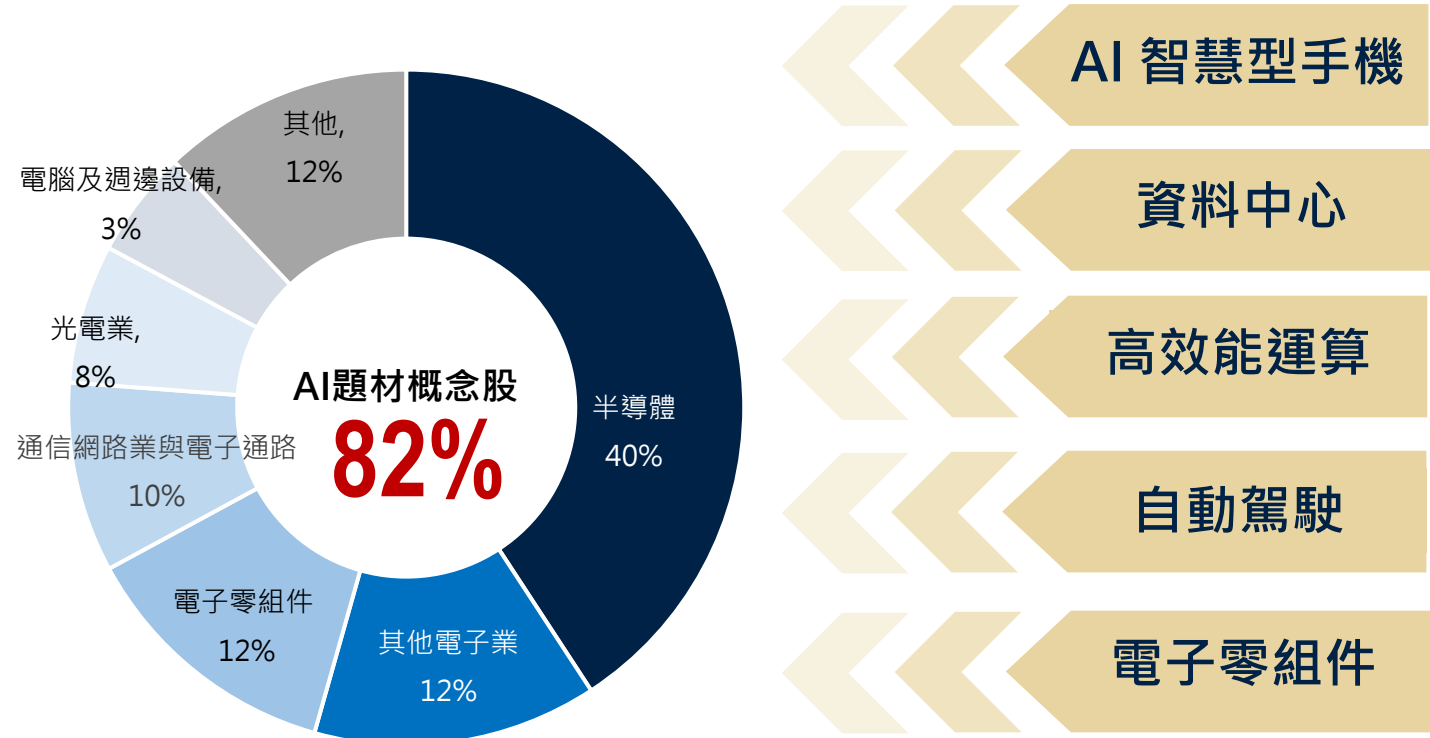
資料來源：Bloomberg · 電子指數截至2024/8/30 · 保德信投信整理。

注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或投資之標的。

基金特色 | Essential 關鍵供應鏈

AI佔比高達8成

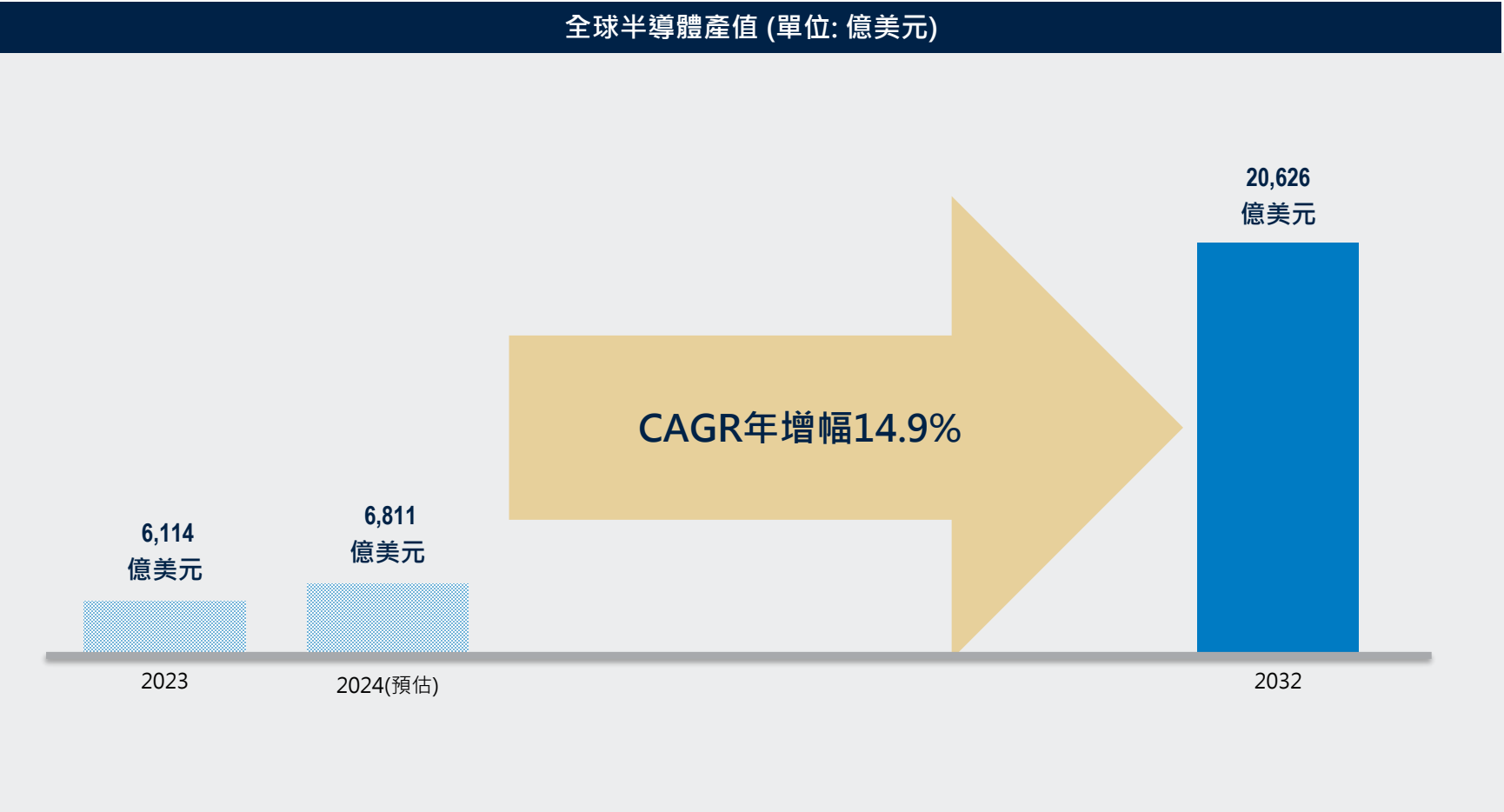
PGIM保德信科技島基金持股配置



資料來源：基智網；2024/9/13。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

基金特色 | Chips

半導體為主 精選持股30-50檔



資料來源：左圖- Fortune Business Insights, 2024/5/13；右圖：TrendForce，2024/2/23，保德信投信整理，2024/9/2。

掌握AI趨勢 盡在PGIM保德信科技島

PGIM保德信科技島基金前十大持股簡介			
公司	相關領域	8/31 權重	公司簡介
台積電	半導體-晶片代工	10.10%	全球晶片代工龍頭。
京元電	半導體-晶片封測	6.81%	IC測試大廠，也是全球最大AI GPU晶片測試廠之一
旺矽	半導體-晶片封測	4.03%	半導體測試探針卡廠。
文晔	電子通路-電子零組件	5.37%	半導體相關零組件代理經銷業務。
奇鋌	電腦及週邊設備-散熱	5.13%	散熱模組大廠，強項為3D VC技術，應用於伺服器、網通產品等。
致茂	其他電子業-晶片封測	5.13%	半導體系統級測試設備廠。
穎崙	半導體-晶片封測	4.15%	從事研究、製造及銷售半導體測試介面及配套產品。
鴻海	其他電子業-伺服器組裝	3.97%	專注於電子產品的代工服務與組裝。
華通	電子零組件-PCB零組件	4.45%	PCB零組件廠。
力成	半導體-晶片封測	3.18%	業務主力為記憶體積體電路之封裝測試業務，為全球前五大封測廠。

資料來源：Bloomberg，保德信投信整理，2024/8/31。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

結論

■ 投資亮點

- AI熱潮為美國科技帶來強動能，訂單滿載將持續放大企業獲利，相關台廠半導體上、中、下游供應鏈將直接受惠，加上AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求，隨龍頭大廠引領的AI晶片加速進入市場，相關終端電子需求將推升台廠產能火力全開。
- 初估2026年半導體產業獲利將突破8千億美元大關，加上AI手機、AI PC嶄新登場，預期在相關終端電子需求帶動下，半導體產能將推升台廠持續上攻，年營收佔比可望拿下全球7成市佔的台廠晶圓代工，將為整體產業供應鏈引爆訂單量。

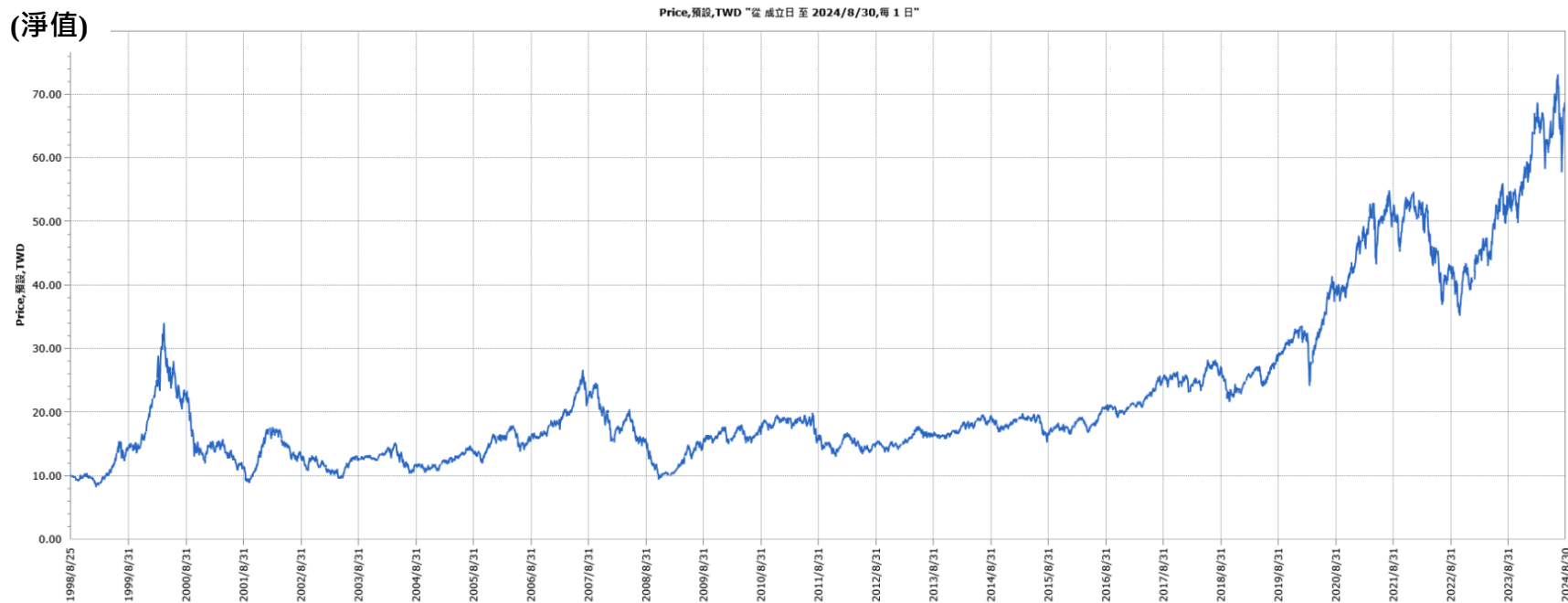
■ 基金操作策略

- **掌握關鍵科技供應鏈趨勢**：在生成式潮流帶動下，大型雲端及系統業者加大AI server相關支出，規格大幅提升有利於相關供應鏈需求，如半導體測試、設備、散熱及電子零組件等皆可望受惠。
- **高度持有半導體、AI相關概念股**：目前半導體相關類股佈局達近4成，AI題材概念股則高達8成以上；其中AI需求帶動的晶圓代工、測試介面、散熱與先進封裝將為主要佈局重點，此外，亦將伺機回補IP、IC設計等相關族群類股。
- **集中持股，靈活調整**：透過草根研究實地走訪，由精選80檔個股進行深入分析，最終將30~50檔最具競爭力的個股納入投組，截至8月底，前十大持股合計比重53.7%。

資料來源：保德信投信整理，2024/9；以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

PGIM保德信科技島基金

PGIM保德信科技島基金成立以來淨值走勢



	3M	6M	1Y	2Y	3Y	年初以來	成立以來
PGIM保德信科技島基金	8.89%	3.07%	29.27%	60.48%	32.78%	16.20%	588.60%

資料來源：Lipper，保德信投信整理，截至2024/8/31，以台幣報酬計算。過去之績效不代表未來績效之保證。

PGIM保德信科技島基金

基本資料

類別	股票型-投資國內-科技類
成立時間	1998/8/25
經理人	黃新迪*
彭博代碼	MSLHITI.TT

基金績效 (%)

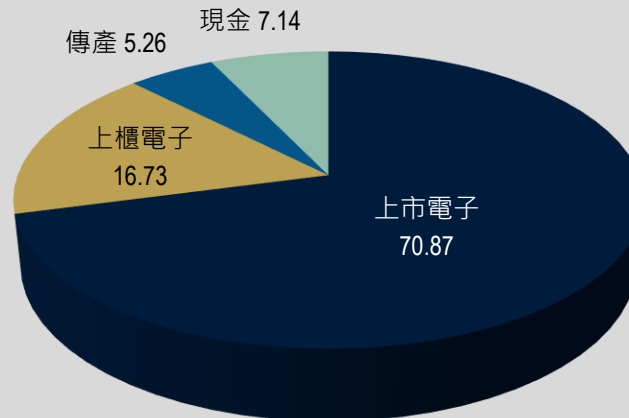
3個月	8.89
6個月	3.07
1年	29.27
2年	60.48
3年	32.78
5年	137.69
10年	257.71
今年以來	16.20
成立以來	588.60

基金特色

- 配合科技類股景氣循環，密切注意市場動態，以靈活管理基金投資組合
- 採Bottom-up 的選股方式，於上市、上櫃之科技類股尋找優質投資標的
- 以產業前景為優先考量因素，兼顧上市、上櫃科技股潛在成長契機

投資組合

基金規模：台幣24.18億元



(以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。)

基金績效和投資組合比重單位為%。資料來源：Lipper，分類標準為投信投顧公會、保德信投信。資料時間：2024/08/31。過去之績效不代表未來績效之保證。*註：自2024年03月23日起接任。

保德信投信獨立經營管理 | 保德信及其岩石商標為專有服務標誌，未經本公司事先同意前，不得使用。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用)，投資人可至保德信投資理財網www.pgim.com.tw、公開資訊觀測站mops.twse.com.tw(境內基金適用)或境外基金觀測站announce.fundclear.com.tw(境外基金適用)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

1004-5 PGIMSITE20241011

保德信證券投資信託股份有限公司

台北總公司：110台北市信義區基隆路一段333號14樓

Tel：(02) 8726-4888

Fax：(02) 2763-8889

台中分公司：407台中市西屯區市政路402號5樓之5

Tel：(04) 2252-5818

Fax：(04) 2252-5808

高雄分公司：804高雄市鼓山區明誠三路679號5樓

Tel：(07) 586-7988

Fax：(07) 586-7688